

(19) 世界知的所有権機関  
国際事務局



(43) 国際公開日  
2005 年 3 月 24 日 (24.03.2005)

PCT

(10) 国際公開番号  
WO 2005/027604 A1

- (51) 国際特許分類: H05K 3/32  
(21) 国際出願番号: PCT/JP2004/006677  
(22) 国際出願日: 2004 年 5 月 12 日 (12.05.2004)  
(25) 国際出願の言語: 日本語  
(26) 国際公開の言語: 日本語  
(30) 優先権データ:  
特願2003-317452 2003 年 9 月 9 日 (09.09.2003) JP  
(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): ソニーケミカル株式会社 (SONY CHEMICALS CORPORATION) [JP/JP]; 〒1410032 東京都品川区大崎一丁目 1 番 2 号 ゲートシティ大崎イーストタワー 8 階 Tokyo (JP).  
(72) 発明者; および  
(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 小西 美佐夫 (KONISHI, MIsao) [JP/JP]; 〒3228502 栃木県鹿沼市

さつき町 1 2 - 3 ソニーケミカル株式会社 鹿沼事業所第 2 工場内 Tochigi (JP). 波木 秀次 (NAMIKI, HIdetsugu) [JP/JP]; 〒3228502 栃木県鹿沼市さつき町 1 2 - 3 ソニーケミカル株式会社 鹿沼事業所第 2 工場内 Tochigi (JP). 篠崎 潤二 (SHINOZAKI, Jyunji) [JP/JP]; 〒3228502 栃木県鹿沼市さつき町 1 2 - 3 ソニーケミカル株式会社 鹿沼事業所第 2 工場内 Tochigi (JP).

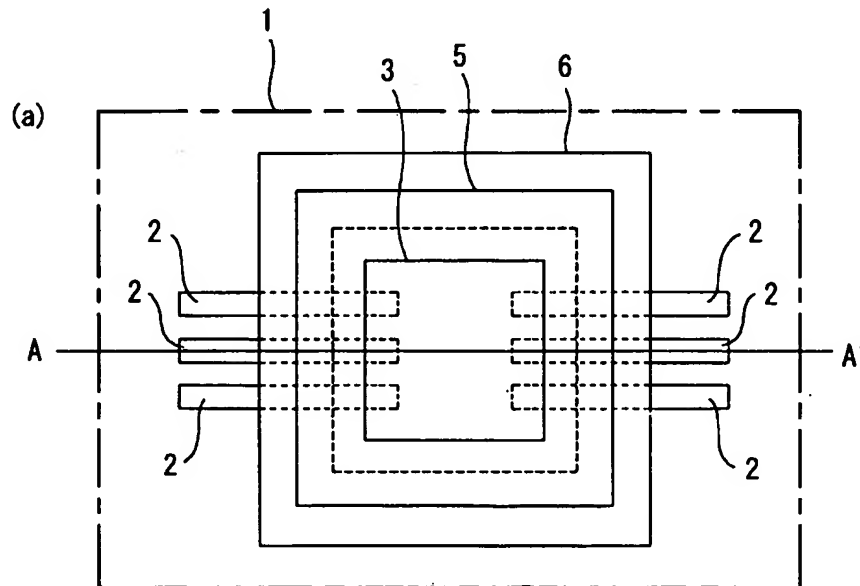
(74) 代理人: 佐藤 勝 (SATO, Masaru); 〒1358071 東京都江東区有明 3 - 1 有明国際特許事務所 Tokyo (JP).

(81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG,

/続葉有/

(54) Title: METHOD FOR MOUNTING ELECTRONIC COMPONENT

(54) 発明の名称: 電子部品の実装方法



(57) Abstract: A method for mounting an electronic component (3) on a printed board (flexible board (1)) provided with a wiring pattern (2) through an adhesive sheet, i.e. an anisotropic conductive film (5). In a state where the air existing between the anisotropic conductive film (5) and the flexible board (1) is heated, the anisotropic conductive film (5) is bonded to a region of the flexible board (1) where the electronic component (3) is mounted. Since the volume of the air confined between the anisotropic conductive film and the flexible board reduces through cooling, production of voids and exposure of the wiring pattern are avoided. Consequently, reliability can be enhanced without complicating the mounting.

/続葉有/

WO 2005/027604 A1



SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ,  
VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN,  
TD, TG).

- (84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF,

添付公開書類:

— 国際調査報告書

2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

(57) 要約: 配線パターン(2)が設けられたプリント基板(フレキシブル基板(1))に、接着シートである異方性導電膜(5)を介して電子部品(3)を実装する電子部品の実装方法である。上記異方性導電膜(5)と上記フレキシブル基板(1)との間に介在する空気を加熱した状態で、上記フレキシブル基板(1)の上記電子部品(3)が実装される領域に異方性導電膜(5)を貼り付ける。異方性導電膜とフレキシブル基板との間に閉じこめられた空気は、冷却により体積が減少し、ボイドの発生や配線パターンの露出等が回避される。これにより、実装を煩雑にすることなく信頼性の向上を図ることができる。